



平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年7月28日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2760 URL <http://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000
 四半期報告書提出予定日 平成28年8月8日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	29,387	3.4	△62	—	75	△86.8	64	△82.4
28年3月期第1四半期	28,416	9.5	697	547.5	569	627.1	369	499.0

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 66百万円(△81.4%) 28年3月期第1四半期 359百万円(689.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第1四半期	6.48	—
28年3月期第1四半期	37.00	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年3月期第1四半期	64,535	21,957	34.0
28年3月期	64,284	22,174	34.5

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 21,954百万円 28年3月期 22,171百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	30.00	—	30.00	60.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29年3月期(予想)	—	30.00	—	30.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	58,300	2.0	300	△53.7	210	△49.6	20.95
通期	123,000	4.4	1,700	4.4	1,130	22.1	112.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

29年3月期1Q	10,445,500株	28年3月期	10,445,500株
29年3月期1Q	403,719株	28年3月期	423,819株
29年3月期1Q	10,030,848株	28年3月期1Q	9,978,939株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び従業員持株ESOP信託を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(4) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8
4. 補足情報	9
(1) 仕入、受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境に改善が見受けられるものの、生産動向や消費者マインドは足踏み状態となっており、景気回復は停滞しております。また、中国や一部の新興国における経済の減速懸念、為替の乱高下による実体経済への影響など、景気の先行きに対してはより一層不透明感が高まっております。

当社グループにおける当第1四半期連結累計期間の業績については、売上高293億8千7百万円（前年同期比3.4%増）、売上高が増加した一方、半導体及び電子デバイス事業における取扱い製品構成の変化等により営業損失6千2百万円（前年同期は営業利益6億9千7百万円）、為替差益を計上したことなどにより経常利益7千5百万円（前年同期比86.8%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益6千4百万円（前年同期比82.4%減）となりました。

報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

（半導体及び電子デバイス事業）

半導体全般の需給バランスが依然として調整局面にある中、産業機器等への需要は緩やかな回復に向かっております。一方、前年同四半期と比べ円高基調で推移していることから、輸出企業には厳しい事業環境が続いております。

このような状況のもと、ザイリンクス社との販売代理店契約解消の影響で産業機器及び通信機器向けカスタムICの販売減少があったものの、ストレージや車載向けの販売が堅調に推移したことなどから当第1四半期連結累計期間における売上高は256億4千9百万円（前年同期比5.8%増）となりました。一方、取扱い製品構成の変化や急激な為替変動などによりセグメント損失（経常損失）は8百万円（前年同期はセグメント利益3億7千3百万円）となりました。

（コンピュータシステム関連事業）

通信事業の分野でIT投資意欲が高まっており、重点領域としてはリスク対策のほか、データ量増大に対応する効率的なネットワーク運用に向けた、仮想化技術等に注目が集まっております。

このような状況のもと、企業向けに総じて機器販売が底堅く推移したものの、前年同四半期に好調であった官公庁向け機器販売の反動減等により当第1四半期連結累計期間における売上高は37億3千8百万円（前年同期比10.6%減）、セグメント利益（経常利益）は8千3百万円（前年同期比57.3%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は645億3千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億5千1百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少した一方、現金及び預金が増加したことによります。負債総額は425億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億6千7百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が増加したことによります。また、純資産総額は219億5千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億1千6百万円の減少となりました。以上の結果、自己資本比率は34.0%となり、前連結会計年度末に比べ0.5ポイント低下いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期連結累計期間の業績については概ね当初の見通しに基づき推移しており、今後の動向を勘案した結果、前回（平成28年4月26日）公表の第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想は修正しておりません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

(4) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,637	3,757
受取手形及び売掛金	28,902	28,243
電子記録債権	627	726
商品及び製品	21,527	21,503
その他	5,644	5,456
流動資産合計	59,340	59,688
固定資産		
有形固定資産	870	864
無形固定資産	772	684
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	177	187
その他	3,135	3,123
貸倒引当金	△11	△11
投資その他の資産合計	3,301	3,298
固定資産合計	4,944	4,847
資産合計	64,284	64,535
負債の部		
流動負債		
買掛金	8,694	7,862
短期借入金	10,680	11,993
1年内返済予定の長期借入金	2,096	2,096
賞与引当金	712	221
その他	6,005	6,543
流動負債合計	28,189	28,716
固定負債		
長期借入金	6,288	6,264
退職給付に係る負債	7,080	7,050
その他	552	547
固定負債合計	13,921	13,861
負債合計	42,110	42,578
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,645	5,645
利益剰余金	14,917	14,668
自己株式	△628	△598
株主資本合計	22,430	22,211
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△8	△18
繰延ヘッジ損益	77	234
為替換算調整勘定	215	52
退職給付に係る調整累計額	△542	△525
その他の包括利益累計額合計	△258	△256
非支配株主持分	2	2
純資産合計	22,174	21,957
負債純資産合計	64,284	64,535

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年6月30日)
売上高	28,416	29,387
売上原価	24,350	26,168
売上総利益	4,065	3,218
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	1,450	1,408
賞与引当金繰入額	292	212
退職給付費用	130	204
その他	1,494	1,455
販売費及び一般管理費合計	3,368	3,281
営業利益又は営業損失(△)	697	△62
営業外収益		
受取保険金	23	14
為替差益	-	150
その他	8	12
営業外収益合計	32	176
営業外費用		
支払利息	18	23
為替差損	127	-
その他	14	15
営業外費用合計	160	39
経常利益	569	75
特別利益		
ゴルフ会員権売却益	-	0
関係会社出資金売却益	8	-
特別利益合計	8	0
特別損失		
固定資産除却損	2	1
投資有価証券売却損	9	-
特別損失合計	11	1
税金等調整前四半期純利益	566	75
法人税等	196	10
四半期純利益	369	64
親会社株主に帰属する四半期純利益	369	64

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年6月30日)
四半期純利益	369	64
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5	△10
繰延ヘッジ損益	14	157
為替換算調整勘定	31	△162
退職給付に係る調整額	△35	17
持分法適用会社に対する持分相当額	△16	△0
その他の包括利益合計	△10	1
四半期包括利益	359	66
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	359	66
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	566	75
減価償却費	118	116
のれん償却額	25	25
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△436	△488
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△61	△15
支払利息	18	23
投資有価証券売却損益 (△は益)	9	-
関係会社出資金売却損益 (△は益)	△8	-
売上債権の増減額 (△は増加)	2,667	△121
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,605	△531
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,782	△682
未払金の増減額 (△は減少)	△452	△46
前受金の増減額 (△は減少)	1,318	903
未収消費税等の増減額 (△は増加)	2,972	556
未収入金の増減額 (△は増加)	△3,036	219
前払費用の増減額 (△は増加)	△437	△424
その他	182	82
小計	4,268	△308
利息及び配当金の受取額	0	5
利息の支払額	△19	△23
法人税等の支払額	△566	△82
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,682	△408
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△5	△44
無形固定資産の取得による支出	△37	△11
非連結子会社設立による支出	-	△33
その他	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41	△87
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△3,901	1,979
長期借入金の返済による支出	△24	△24
自己株式の処分による収入	28	30
配当金の支払額	△299	△300
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,195	1,685
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	△69
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△544	1,119
現金及び現金同等物の期首残高	2,302	2,637
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,757	3,757

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	24,235	4,181	28,416	—	28,416
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	24,235	4,181	28,416	—	28,416
セグメント利益	373	195	569	—	569

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	25,649	3,738	29,387	—	29,387
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	25,649	3,738	29,387	—	29,387
セグメント利益又は 損失(△)	△8	83	75	—	75

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

4. 補足情報

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第1四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	23,651	31.2
コンピュータシステム関連事業	2,525	△10.8
合計	26,176	25.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	27,388	14.0	17,071	19.4
コンピュータシステム関連事業	3,976	△17.8	7,450	△2.5
合計	31,365	8.6	24,521	11.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	25,649	5.8
コンピュータシステム関連事業	3,738	△10.6
合計	29,387	3.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。